



2018年4月4日

各 位

会 社 名： 東京エレクトロン株式会社
代表者名： 代表取締役社長 河合 利樹
(コード番号：8035 東証第1部)
問合せ先： 総務部長 阿曾 達也
(TEL 03-5561-7000)

子会社(NEXX社)株式譲渡に関するお知らせ

東京エレクトロン株式会社(本社：東京都港区、社長：河合利樹)は、半導体組立・パッケージング装置および表面実装アプリケーションの世界大手 ASM Pacific Technology Ltd. (以下 ASMPT 社)と、当社の連結子会社である TEL NEXX, Inc. (以下 NEXX 社)の株式譲渡につき、契約締結に至りましたことをお知らせします。なお、株式譲渡の効力発生には関係当局の認可が必要となるため、2018年末頃の譲渡完了を見込んでおります。

また、当社の連結業績に与える影響につきましては、2019年3月期の業績予想を現在精査中であり、本件に関して業績見通しに重要な影響がある場合は適時開示いたします。

NEXX 社について

事業分野：ウェーハレベル・先端パッケージング向けめっき装置および PVD 装置
本社：米国マサチューセッツ州ビレリカ
従業員数：117名(2018年3月1日時点)

NEXX 社は、先端パッケージング分野において、めっき装置および PVD 装置を優れた技術ソリューションと高い生産性を持ってお客様に提供しており、2001年に創業。2012年に東京エレクトロン株式会社が買収し、Tokyo Electron U.S. Holdings, Inc.の100%子会社となりました。

ASMPT 社について

事業分野：半導体組立・パッケージングおよび表面実装技術に関する先端ソリューションとマテリアル
本社：シンガポール
従業員数：16,400名(2017年12月期末時点)
売上高：22.5億米ドル(2017年12月期)

ASMPT 社 (HKEX 株式コード：0522)は、半導体組立・パッケージング装置分野における技術とマーケットのグローバル・リーダーとして、技術開発、先端ソリューションの提供を行っています。また、同社の表面実装技術は電子機器、モバイル通信機器、自動車、産業機器、LED、新エネルギーなど、最終製品市場の幅広い分野において用いられています。

ASMPT 社は、1989年香港証券取引所に上場し、現在 Hang Seng Composite MidCap Index (Hang Seng Composite Size Indexes の一指数)、Hang Seng Composite Information Technology Industry Index (Hang Seng Composite Industry Indexes の一指数)、Hang Seng Hong Kong 35 Index、Hang Seng Global Composite Index 等、各種インデックスの構成銘柄となっております。ASMPT 社に関する詳細情報は同社ウェブサイトをご覧ください。www.asmpacific.com

以 上

なお、関係者のコメントは【別紙】をご参照ください。

【別紙】

東京エレクトロン株式会社 代表取締役社長 兼 CEO 河合利樹のコメント：

「NEXX 社の事業は、先端ウェーハレベル・パッケージング向けめっき装置および PVD 装置事業を拡大する絶好の機会を得たことで、ASMPT 社の顧客である半導体組立検査受託会社との連携により、さらに大きなシナジーを得られるものと確信しています。」

ASM Pacific Technology Ltd. CEO Lee Wai Kwong 氏のコメント：

「この戦略的買収は、ASMPT 社の先端パッケージングアプリケーション分野を補完するものであり、最高の付加価値と革新的なソリューションを顧客へ提供し、イノベーションを起こすという我々のコミットメントを支え、ASMPT 社をインターコネクト・テクノロジーのトップカンパニーとするものです。NEXX 社のめっき装置および PVD 装置に関する高度専門技術を融合することで、データ・セントリック時代の幕明けを迎えるこの時に、市場の成長に寄与する素晴らしい機会を ASMPT 社は得たものと考えています。」

TEL NEXX, Inc. President Tom Walsh 氏のコメント：

「半導体需要が歴史的な高水準となる中、ASMPT 社とともに歩むことにより、既存顧客向けの販売・サービス能力の拡充に加え、グローバルな顧客層の拡大につなげることができると期待しています。」